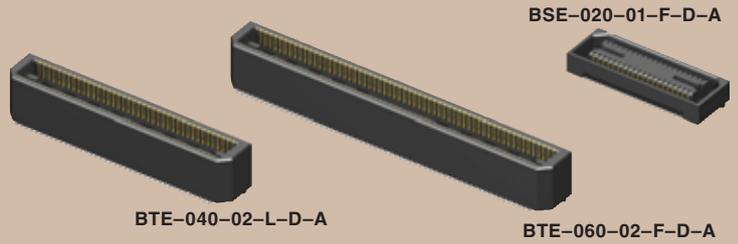




(0,80 mm) .0315"

BTE, BSE 系列



基础端子条和插座条

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?BTE 或 www.samtec.com?BSE

绝缘体材料: 液晶聚合物
触点材料: 磷铜
电镀: 在 50µ" (1,27 µm) 的镍上镀金或锡
额定电流: 2A 每针 @ 80°C 环境和 5 mm 堆叠高度
工作温度范围: -55°C 至 +125°C
额定电压: 225 VAC 和 5 mm 堆叠高度
最大循环数: 100
符合 RoHS 规范要求: 是

加工:
 可无铅焊接: 是
SMT 引线共面度: 最大 (0,10 mm) .004" (020-080) 最大 (0,15 mm) .006" (100-120)
电路板相叠: 对于每板或不少于 80 个位置需要超过两个连接器的应用, 请发邮件至 ipg@samtec.com

堆叠高度

引线式样	堆叠高度*
-01	(5,00) .197
-02	(8,00) .315

*加工条件将影响配接高度。

特殊应用选项

- 30µ" (0,76 µm) 镀金
- 边缘封装能力
- 磨擦锁紧选择
- 11 mm, 14 mm, 16,10 mm, 19,10 mm, 22 mm, 25 mm 和 30 mm 堆叠高度 (注意: 有些自动置放/检验设备可能对组件高度有限制。请参考设备规范。)

请致电 Samtec。

*注: -C 电镀已通过十年 MFG 测试
 注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

BTE 每排位置数

配接: BSE

-020, -040, -060, -080, -100, -120

从图表中指定引线式样

引线式样	A
-01	(4,27) .168
-02	(7,21) .284

-F = 触点闪镀金, 尾端镀雾锡
-L = 10µ" (0,25 µm) 触点镀金, 尾端镀雾锡
-C* = 选择性电抛光 触点区信号针脚的 150µ" (3,81 µm) 的镍底上至少 50µ" (1,27 µm) 镀金, 触点区接地面 50µ" (1,27 µm) 的镍底上至少 10µ" (0,25 µm) 镀金, 所有焊接尾端至少 50µ" (1,27 µm) 的镍底上镀雾锡

-K = (7,00 mm) .275" 直径 聚酰亚胺薄膜 膜取 放垫
-TR = 卷带封装 (最多 60 个位置)

BSE 每排位置数

配接: BTE

-020, -040, -060, -080, -100, -120

01

-F = 触点闪镀金, 尾端镀雾锡
-L = 10µ" (0,25 µm) 触点镀金, 尾端镀雾锡
-C* = 选择性电抛光 触点区信号针脚的 150µ" (3,81 µm) 的镍底上至少 50µ" (1,27 µm) 镀金, 触点区接地面 50µ" (1,27 µm) 的镍底上至少 10µ" (0,25 µm) 镀金, 所有焊接尾端至少 50µ" (1,27 µm) 的镍底上镀雾锡

-TR = 卷带封装 (最多 80 个位置)